

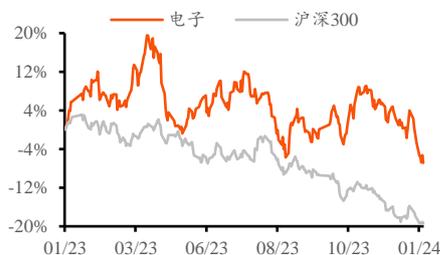
CES2024 参展商超 4000 家，AI 是全场焦点
——电子行业周报（2024.01.08-2024.01.12）



增持(维持)

行业： 电子
日期： 2024年01月15日
分析师： 陈宇哲
E-mail： chenyzhe@yongxingsc.com
SAC 编号： S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告：

《台积电 CoWos 满载，CES2024 即将召开》

——2024 年 01 月 08 日

《SK 计划 2024 启动 HBM4 研发，OWS 耳机销量高增》

——2024 年 01 月 05 日

《存储涨价预期升温，华邦力成携手开发先进封装》

——2023 年 12 月 26 日

核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

HBM: 三星购买设备推进 HBM 生产，HBM 产业链有望持续受益。

三星订购数十台热压 (TC) 键合机，其为制造高带宽内存和 DDR5 的必备设备，三星 2024 年可能会专注于先进 DRAM 的生产。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 生产，HBM 产业链有望持续受益。

AIPC: Canals 预计 27 年 AIPC 占比将达 60%，相关产业链有望持续受益。根据 Canals 报告，在 2024 年出货的 PC 中，AI PC 占比将会接近五分之一，预计到 2027 年比例将增长到 60% 以上。我们认为，AIPC 渗透率有望加速提升，相关产业链有望持续受益。

存储芯片: TrendForce 预估 Q1 NAND 涨幅约 15~20%，相关产业链有望持续受益。买方持续扩大 NAND Flash 产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估 2024 年第一季 NAND Flash 合约价季涨幅约 15~20%。我们认为，存储芯片价格有望继续回升，相关产业链有望持续受益。

先进封装: 台积电将继续扩大 CoWoS 产能，相关产业链有望持续受益。为响应英伟达及 AMD 对先进封装的强劲需求，台积电将持续扩大 CoWoS 等先进封装产能。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周 (1.8-1.12)，A 股申万电子指数下跌 4.31%，整体跑输沪深 300 指数 2.96pct，跑输创业板综指数 2.87pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：元件(-3.24%)、其他电子 II(-3.42%)、光学光电子(-3.46%)、电子化学品 II(-4.01%)、消费电子(-4.75%)、半导体(-4.77%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(5.02%)、纳斯达克(3.09%)、费城半导体(3.02%)、台湾电子(0.64%)、恒生科技(-3.39%)、申万电子(-4.31%)。

投资建议

本周我们继续看好受益先进算力芯片发布的 HBM 产业链、受益 AI 赋能的 AIPC 产业链、以存储、封装为代表的半导体周期复苏主线。

HBM: 受益于英伟达发布 H200 算力芯片，HBM 产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

AIPC: 受益于 AI 赋能带来的创新体验和销量提升，相关产业链有望加速受益，建议关注龙芯中科、春秋电子、智微智能、华勤技术等；

存储芯片: 受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM 与 DDR5 需求上升，存储产业链有望实现探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等；

先进封装: 半导体大厂持续布局先进封装，产业链相关公司有望受益并迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议	3
2. 市场回顾	5
2.1. 板块表现	5
2.1. 个股表现	7
3. 行业新闻	8
4. 公司动态	11
5. 公司公告	13
6. 风险提示	14

图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (1.8-1.12)	5
图 2: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (1.8-1.12)	5
图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (1.8-1.12)	6
图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (1.8-1.12)	6

表目录

表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (1.8-1.12)	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (1.8-1.12)	13

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点:

HBM: 三星购买设备推进 HBM 生产, HBM 产业链有望持续受益。根据 The ELEC 报道,三星已从子公司 Semes 订购了数十台热压 (TC) 键合机。由于 TC 键合机用于堆叠 DRAM, 并且是制造高带宽内存 (HBM) 和 DDR5 的必备设备, 因此该订单表明三星 2024 年可能会专注于先进 DRAM 的生产。鉴于 TC 键合机的订单量很大, 预计三星还将订购泛林集团制造的 Syndion (用于硅通孔蚀刻)、Damascene SABRE 3D, 这两种设备也用于 HBM 的生产。我们认为, 各大存储厂持续积极推进 HBM 生产, HBM 产业链有望持续受益。

AI PC: Canalsy 预计 27 年 AIPC 占比将达 60%, 相关产业链有望持续受益。根据 Canalsy 报告, 在 2024 年出货的 PC 中, AIPC 占比将会接近五分之一, 并预计到 2027 年, 得益于换机动能和全新本地体验, 这一比例将迅速增长到 60% 以上。到 2027 年, AIPC 出货量的 60% 将应用到商用领域。对 Windows 10 的支持已经接近尾声, 这将推动 2024 年至 2025 年的重要更新周期, 为用户迁移到 AIPC 提供了机会。随着 AI 功能的优势日渐明显, 商业应用将快速增加, 到 2025 年, 整个类别的出货量将超过 1 亿台。从长远来看, 到 2027 年, 将有超过 60% 的商用 PC 具备 AI 功能, 这一数字凸显 AI 改变工作流程的潜力。我们认为, AI PC 渗透率有望加速提升, 相关产业链有望持续受益。

存储芯片: TrendForce 预估 Q1 NAND 涨幅约 15~20%, 相关产业链有望持续受益。根据 TrendForce 集邦咨询研究显示, 尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势, 但为避免缺货, 买方持续扩大 NAND Flash 产品采购以建立安全库存水位, 而供应商为减少亏损, 对于推高价格势在必行, 预估 2024 年第一季 NAND Flash 合约价季涨幅约 15~20%。我们认为, 存储芯片价格有望继续回升, 相关产业链有望持续受益。

先进封装: 台积电将继续扩大 CoWoS 产能, 相关产业链有望持续受益。根据集微网报道, 英伟达、AMD 在 2024 年继续全力冲刺人工智能 (AI) 加速器市场, 预计两家将共同向台积电下单约 150 万颗先进 AI 芯片, 使得台积电先进封装产能表现强劲。投资机构预估, 中国台湾的弘塑、辛耘、钛昇、万润等先进封装设备厂商, 2024 年出货动能有望逐季增加。为响应英伟达及 AMD 对先进封装的强劲需求, 台积电将持续扩大 CoWoS 等先进封装产能。我们认为, 先进封装在算力时代重要性逐步凸显, 相关产业链有望持续受益。

投资建议：

本周我们继续看好受益先进算力芯片发布的 HBM 产业链、受益 AI 赋能的 AIPC 产业链、以存储、封装为代表的半导体周期复苏主线。

HBM：受益于英伟达发布 H200 算力芯片，HBM 产业链有望迎来加速成长，建议关注**赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科**等；

AI PC：受益于 AI 赋能带来的创新体验和销量提升，相关产业链有望加速受益，建议关注**龙芯中科、春秋电子、智微智能、华勤技术**等；

存储芯片：受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM 与 DDR5 需求上升，存储产业链有望实现探底回升。推荐**东芯股份**，建议关注**恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技**等；

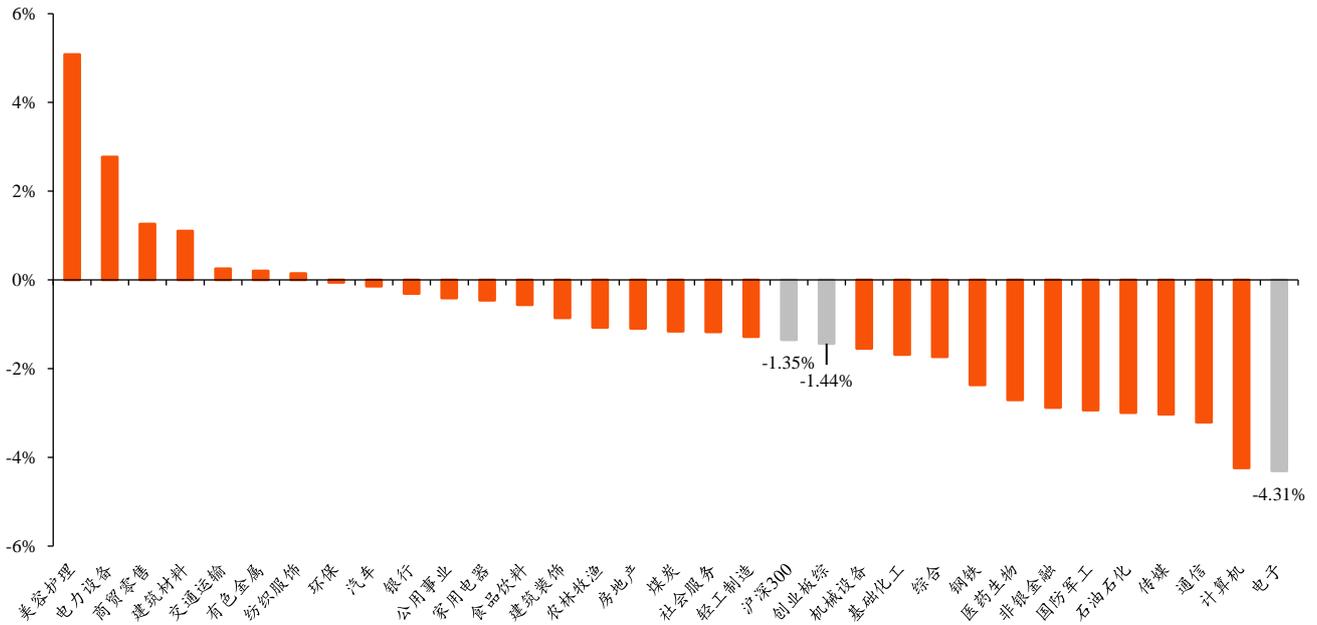
先进封装：半导体大厂持续布局先进封装，产业链相关公司有望受益并迎来加速成长，建议关注**甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子**等。

2. 市场回顾

2.1. 板块表现

本周（1.8-1.12），A股申万电子指数下跌4.31%，板块整体跑输沪深300指数2.96pct，跑输创业板综指数2.87pct。在申万31个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第31位。

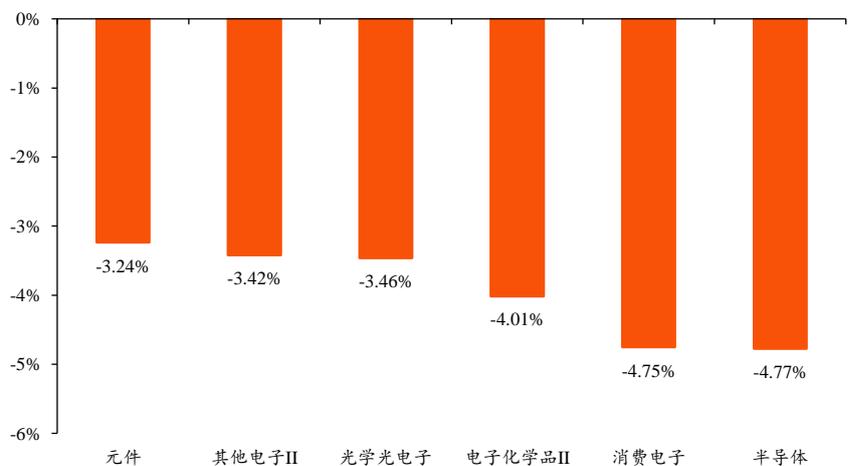
图1:A股申万一级行业涨跌幅情况(1.8-1.12)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（1.8-1.12）申万电子二级行业中，元件板块下跌3.24%，表现较好；半导体板块下跌4.77%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：元件(-3.24%)、其他电子 II(-3.42%)、光学光电子(-3.46%)、电子化学品 II(-4.01%)、消费电子(-4.75%)、半导体(-4.77%)。

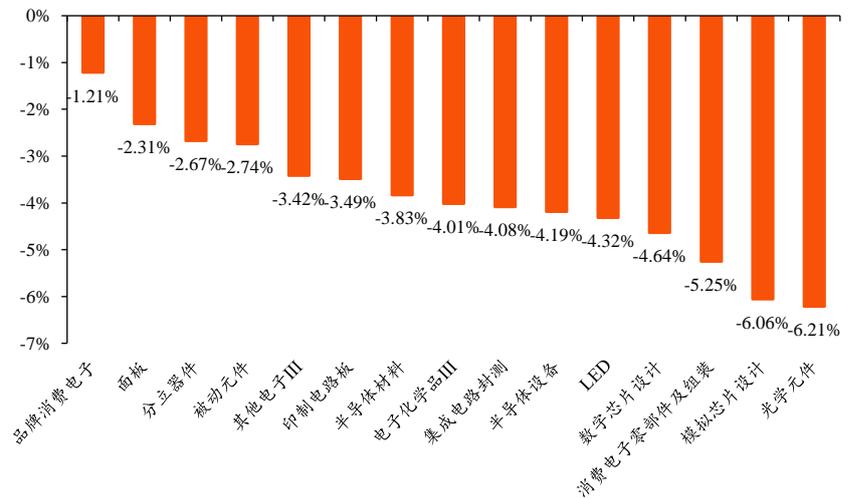
图2:A股申万二级行业涨跌幅情况(1.8-1.12)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（1.8-1.12）申万电子三级行业中，品牌消费电子板块下跌 1.21%，表现较好；光学元件板块下跌 6.21%，表现较差。表现靠前的板块分别为：品牌消费电子(-1.21%)、面板(-2.31%)、分立器件(-2.67%)。表现靠后的板块分别为：光学元件(-6.21%)、模拟芯片设计(-6.06%)、消费电子零部件及组装(-5.25%)。

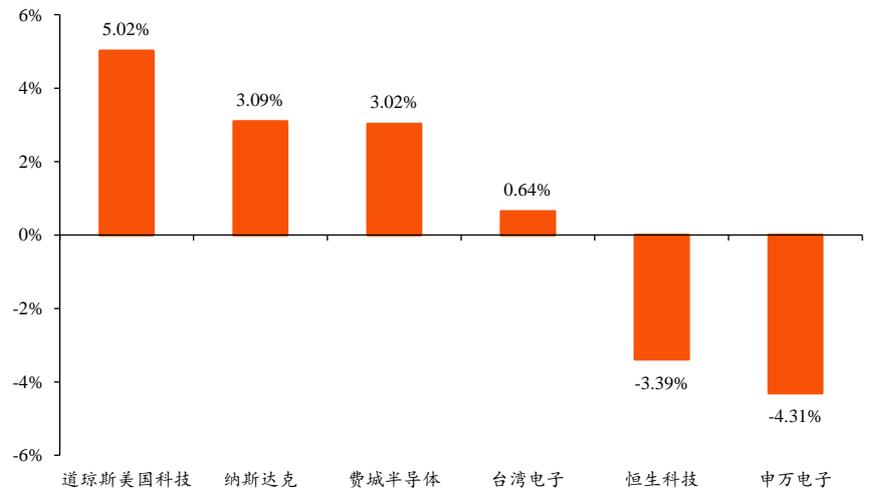
图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（1.8-1.12）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（1.8-1.12），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(5.02%)、纳斯达克(3.09%)、费城半导体(3.02%)、台湾电子(0.64%)、恒生科技(-3.39%)、申万电子(-4.31%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（1.8-1.12）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

2.1. 个股表现

本周（1.8-1.12）个股涨跌幅前十位分别为：商络电子（+12.2%）、GQY 视讯（+9.19%）、法拉电子（+8.85%）、骏亚科技（+6.99%）、江海股份（+6.43%）、英集芯（+5.23%）、伊戈尔（+4.81%）、至纯科技（+4.78%）、高华科技（+4.59%）、西陇科学（+4.56%）。个股涨跌幅后十位分别为：泓禧科技（-24.86%）、惠威科技（-23.21%）、凯华材料（-22.26%）、威贸电子（-21.67%）、雅葆轩（-21.07%）、晶赛科技（-20.78%）、日久光电（-20.18%）、可川科技（-19.71%）、东尼电子（-18.81%）、纬达光电（-18.66%）。

表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（1.8-1.12）

周涨跌幅前 10 名			周涨跌幅后 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
300975.SZ	商络电子	12.20%	871857.BJ	泓禧科技	-24.86%
300076.SZ	GQY 视讯	9.19%	002888.SZ	惠威科技	-23.21%
600563.SH	法拉电子	8.85%	831526.BJ	凯华材料	-22.26%
603386.SH	骏亚科技	6.99%	833346.BJ	威贸电子	-21.67%
002484.SZ	江海股份	6.43%	870357.BJ	雅葆轩	-21.07%
688209.SH	英集芯	5.23%	871981.BJ	晶赛科技	-20.78%
002922.SZ	伊戈尔	4.81%	003015.SZ	日久光电	-20.18%
603690.SH	至纯科技	4.78%	603052.SH	可川科技	-19.71%
688539.SH	高华科技	4.59%	603595.SH	东尼电子	-18.81%
002584.SZ	西陇科学	4.56%	873001.BJ	纬达光电	-18.66%

资料来源：Wind，甬兴证券研究所

3. 行业新闻

Canalys 预测：2024 年，智能手表将以 17% 的增长率强势反弹

1 月 8 日消息，根据 Canalys 报告，全球可穿戴腕带设备分析预测数据显示，2023 年该品类的总销量为 1.86 亿台，增长 2%。而其增长的主要动力是新兴市场（尤其是印度），其基础手表的出货量大幅增长 22%。这一增长有效抵消其他两个细分品类的颓势，分别来自智能手表和基础手环 9% 的下滑。展望未来，可穿戴腕带设备即将迈入更加持续的增长阶段。Canalys 预测 2024 年可穿戴腕带设备的增长率将达到 10%。全球对智能手表的兴趣回升推动这一积极趋势，预计其出货量将增长 17%。

资料来源：(Canalys)

英伟达、AMD AI 芯片 2024 年将生产 150 万颗，先进封装设备商受惠

1 月 8 日消息，根据集微网报道，英伟达、AMD 在 2024 年继续全力冲刺人工智能（AI）加速器市场，预计两家将共同向台积电下单约 150 万颗先进 AI 芯片，使得台积电先进封装产能表现强劲。投资机构预估，中国台湾的弘塑、辛耘、钛昇、万润等先进封装设备厂商，2024 年出货动能有望逐季增加。为响应英伟达及 AMD 对先进封装的强劲需求，台积电将持续扩大 CoWoS 等先进封装产能，因此看好负责封装湿制程设备的弘塑及辛耘，钛昇科技的电浆及激光设备，万润的点胶机、AOI 与植散热片压合机等相关先进封装设备概念股，2024 年出货都有望逐季畅旺。

资料来源：(集微网)

三星向子公司 Semes 订购数十台 TC 键合机，提升 HBM 和 DDR5 产能

1 月 8 日消息，根据 The ELEC 报道，三星已从子公司 Semes 订购了数十台热压（TC）键合机。由于 TC 键合机用于堆叠 DRAM，并且是制造高带宽内存（HBM）和 DDR5 的必备设备，因此该订单表明三星 2024 年可能会专注于先进 DRAM 的生产。鉴于 TC 键合机的订单量很大，预计三星还将订购泛林集团制造的 Syndion（用于硅通孔（TSV）蚀刻）、Damascene SABRE 3D，这两种设备也用于 HBM 的生产。

资料来源：(THE ELEC)

Canalys 预测：2027 年超过 60% 出货的 PC 将是 AI PC

1 月 9 日消息，根据 Canalys 报告，在 2024 年出货的 PC 中，AI PC 占比将会接近五分之一（20%）。到 2027 年，得益于换机动能和全新本地体验，这一比例将迅速增长到 60% 以上。比起消费者，企业将更积极地采用 AI 技术。到 2027 年，AI PC 出货量的 60% 将应用到商用领域。对 Windows 10 的支持已经接近尾声，这将推动 2024 年至 2025 年的重要更新周期，为用户迁移到 AI PC 提供了机会。随着 AI 功能的优势日渐明显，商业应用将

快速增加，到 2025 年，整个类别的出货量将超过 1 亿台。从长远来看，到 2027 年，将有超过 60% 的商用 PC 具备 AI 功能，这一数字凸显 AI 改变工作流程的潜力。

资料来源: (Canalys)

TrendForce: 预估 2024 年第一季 NAND Flash 合约价平均季涨幅 15~20%

1 月 9 日消息，根据 TrendForce 集邦咨询研究显示，尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势，但为避免缺货，买方持续扩大 NAND Flash 产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估 2024 年第一季 NAND Flash 合约价季涨幅约 15~20%。值得注意的是，NAND Flash 原厂为减少亏损而急拉价格涨幅，但由于短期内涨幅过高，需求脚步却跟不上，后续价格上涨仍需仰赖 Enterprise SSD 拉货动能恢复。2024 年第一季供应商的投产步伐不一，随着部份供应商产能利用率提早拉升，新增位元产出将会自第二季发生，若后续需求位元成长未如预期，将对供应商形成压力，可能导致 NAND Flash 下半年价格涨幅收敛。

资料来源: (TrendForces)

Yole: 2029 年，数据中心的半导体价值将达到约 2,050 亿美元，2023-2029 年的复合年均增长率来到 12.8%

1 月 10 日消息，根据 Yole 报告显示，到 2029 年，数据中心的半导体价值将达到约 2,050 亿美元，2023-2029 年的复合年均增长率来到 12.8%。这将占整个服务器市场的 65%。到 2029 年，这 2,050 亿美元将占整个半导体市场的 26%。将占这一市场最高份额的将是内存和处理，而光技术将有最大的增长（约 35%），其驱动力是用于 400G 及更高速光收发器的新兴光芯片，因为预计 2030 年前将达到 3.2Tb。除了插拔式设备，光 I/O 和 CPO 还将整合服务器和网络。由于人工智能服务器（耗电量几乎是标准服务器的十倍）的集成度越来越高，3kW 以上的电源供应单元（PSU）的市场价值将增加。相比之下，小于 1kW 的 PSU 的市场价值预计将略有下降。预计在 2029 年，将有约 2500 万个晶圆是为数据中心所制。这约占全球产量的 17%。

资料来源: (Yole)

TrendForce: 预估 2024 年全球笔电市场需求来到年增 3.6%

1 月 11 日消息，根据 TrendForce 集邦咨询，全球受高通胀冲击，2023 年笔电市场需求欲振乏力，全年出货量仅 1.66 亿台，年减 10.8%，但衰退幅度较 2022 年收敛。2024 上半年随着笔电大厂库存逐渐去化，以及在通胀趋缓的有利条件下，美国近期降息的预测指数攀高，如若市场预期美国联准会最快在 2024 年上半年开始降息，将有助企业融资借贷成本降低、流

动资金水位上扬，加上微软作业系统的世代更迭，借以推进企业用户的系统安全升级，可望带动笔电的汰旧换新需求，因此，TrendForce 集邦咨询预期，2024 年笔电市场需求力道会逐季好转，全球笔记本电脑市场将呈现温和成长，出货年成长率约 3.6%，达 1.72 亿台。

资料来源：(TrendForce)

CES2024：参展商超 4000 家，AI 成绝对主角

1 月 12 日消息，根据 Do News 报道，2024 年 CES 展会在拉斯维加斯举办，AI 成为焦点，三星、LG、TCL 等重点展示最新 AI 产品。三星推出新 AI 芯片 NQ8 AI Gen3，LG 展出首款无线透明 OLED 电视。大众将 ChatGPT 融入车载系统，小鹏展示飞行汽车，自动驾驶技术成热点，英伟达技术被多家中国车企采用。联想发布多款 AI PC。

资料来源：(Do News)

TrendForce：预估 2024 年第一季度 DRAM 合约价季涨幅约 13~18%

1 月 12 日消息，根据 TrendForce 集邦咨询报告，2024 年第一季度 DRAM 合约价季涨幅约 13~18%，其中 Mobile DRAM 持续领涨。目前观察，由于 2024 全年需求展望仍不明朗，故原厂认为持续性减产仍有其必要，以维持存储器产业的供需平衡。

资料来源：(TrendForce)

4. 公司动态

【士兰微】截至 2023 年三季度末公司子公司士兰明镓 6 吋 SiC 功率器件芯片生产线的产能约为 3000 片/月

1 月 8 日消息，士兰微在投资者互动平台表示，截至 2023 年三季度末，公司子公司士兰明镓 6 吋 SiC 功率器件芯片生产线的产能约为 3000 片/月。公司基于 SiC 功率器件芯片的主驱模块已实现向客户的小批量出货。

资料来源：(投资者互动平台)

【光峰科技】目前公司围绕车载显示、AR-HUD 及车灯三大业务线已经获得 6 个定点落地

1 月 8 日消息，光峰科技在投资者互动平台表示，目前，公司围绕车载显示、AR-HUD 及车灯三大业务线已经获得 6 个定点落地，其中公司与赛力斯 M9 合作的定点产品——车规级投影巨幕已正式发布，进入量产交付阶段，公司车载业务在项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。

资料来源：(投资者互动平台)

【沃格光电】公司拥有多家终端车企客户资源

1 月 9 日消息，沃格光电在投资者互动平台表示，公司拥有多家终端车企客户资源，具有多家车企供应商资质。目前公司车载产品主要有车载触控屏、背光模组、Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显等，具体合作情况请以公司公告为准。

资料来源：(投资者互动平台)

【杰华特】公司汽车电子方面现有产品可完整覆盖车载互联、智能驾驶、三电、智能座舱等应用场景

1 月 10 日消息，杰华特在投资者互动平台表示，公司汽车电子方面现有产品可完整覆盖车载互联、智能驾驶、三电、智能座舱等应用场景，并已在这些应用场景积累丰富经验；快充业务主要为配件市场和 Inbox 市场，均有不少成功案例，广泛应用于众多头部客户产品中。公司全面的研发架构，广泛的产品应用，全过程严格的质量管控以及弹性的供应链有助于全方位打造可靠芯片，力争成为推动产业高质量发展的可靠助力。

资料来源：(投资者互动平台)

【慧智微】暂未开展民用版手机卫星宽带芯片等相关项目的研发

1 月 11 日消息，慧智微在互动平台表示，公司暂未开展民用版手机卫星宽带芯片等相关项目的研发。目前公司应用于卫星通信领域的射频前端产品正在研发中。

资料来源：(投资者互动平台)

【冠石科技】公司投建的光掩膜版产品主要应用于集成电路半导体芯片

1月12日消息，冠石科技在投资者互动平台表示，公司投建的光掩膜版产品主要应用于集成电路半导体芯片，且产品制程覆盖350-28nm（其中以45-28nm成熟制程为主），系市场主流中高端产品，可广泛应用于高性能计算、人工智能、移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等众多产业涉及的集成电路半导体领域，能够满足多类晶圆设计、晶圆代工企业的采购需求，以及先进半导体芯片封装、半导体器件等产品的应用需求。

资料来源：(投资者互动平台)

【闻泰科技】公司半导体业务拥有近1.6万种产品料号

1月12日消息，闻泰科技在投资者互动平台表示，公司半导体业务拥有近1.6万种产品料号，每年可交付1,000多亿件产品，包括小信号二极管和晶体管、逻辑芯片、ESD保护器件、车规级PowerMOS、第三代化合物半导体、IGBT等产品，在汽车领域可广泛应用于动力系统、ADAS、车身控制与照明系统等，来自汽车领域的收入占比超过60%。公司通过博世、大陆等Tier1覆盖了广泛的汽车客户，不仅包括传统燃油车，也包括新能源汽车客户。公司半导体业务一方面将凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率；另一方面，加大新产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件（IGBT、SiC和GaN）和模块、12英寸创新产品、模拟IC组合、功率管理IC和信号调节IC等产品研发。

资料来源：(投资者互动平台)

5. 公司公告

表2:电子行业本周重点公告 (1.8-1.12)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/01/08	珠城科技	业绩预告	预计 2023 年全年营业收入 12 至 14 亿元, 同比上年同期增长 14.98% 至 34.14%。预计 2023 年全年归属净利润盈利 1.4 亿元至 1.7 亿元, 同比上年增 27.17% 至 54.42%。
2024/01/08	艾比森	业绩预告	预计 2023 年实现营业收入 40.45 亿元, 同比增长 45%; 归母净利润 3.1 亿元-3.5 亿元, 同比增长 52.7%-72.4%。
2024/01/09	芯瑞达	业绩预告	预计 2023 年净利润 1.59-1.85 亿元, 同比增长 50%-75%; 扣除非经常性损益后的净利润 1.44-1.70 亿元, 同比增长 70%-100%。
2024/01/10	埃科光电	解禁预告	本次股票上市流通总数为 890,831 股。本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日。
2024/01/11	中颖电子	业绩预告	预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润约 1.74 亿元至 1.91 亿元, 同比下降 41% 至 46%; 扣除非经常性损益后的净利润约 0.94 亿元至 1.10 亿元, 同比下降 68.18% 至 72.85%。
2024/01/11	大华股份	业绩预告	预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润约 73.71 亿元, 同比增长 217.1%; 基本每股收益 2.31 元。
2024/01/11	中科飞测	业绩预告	预计 2023 年年度实现营业收入人民币 85,000.00 万元到 90,000.00 万元, 较上年同期相比, 将增加 34,076.47 万元到 39,076.47 万元, 同比增长 66.92% 至 76.74%。预计 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润 11,500.00 万元到 16,500.00 万元, 与上年同期相比, 将增加 10,302.91 万元到 15,302.91 万元, 同比增长 860.66% 至 1,278.34%。
2024/01/12	中京电子	业绩预告	预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润亏损 1.1 亿元至 1.2 亿元。基本每股收益亏损 0.18 元至 0.2 元。

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

6. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。